

阿苏事业所 举行用地协议签订仪式以及扩建工程奠基典礼

近日，为了对现有的阿苏事业所进行工厂扩建，举行了用地协议签订仪式和扩建工程的奠基典礼。现特此公告。

阿苏事业所的扩建，是由于智能手机以及车载用半导体市场的持续坚挺，看好今后蚀刻事业的市场会继续扩大，为此，谋求通过扩建工厂，以实现增强生产能力。

于当地时间7月7日(周五)，在熊本县商工观光劳动部奥菌部长的主持下，丸冈副总裁与西原村日置村长签订了用力协议。

另外，于7月12日(周三)，熊本县相关来宾以及扩建工程承包商共同出席了由西原村当地的白山姬神社斋主主持的阿苏事业所扩建工程奠基典礼。

此次阿苏事业所的扩建工程将于2017年8月开工建设，预计于2018年2月正式投产使用。扩建后的工厂面积将达到现有工厂面积的两倍，并阶段性的逐步提高生产能力，最终计划于2020年7月将生产能力提升至现有产能的3倍。

【签订仪式时的情景】



左起：丸冈副总裁、奥菌部长、日置村长

【奠基典礼时的情景】



【事业计划概要】

- | | |
|------------|--------------------------------|
| (1) 事业所名称 | 三井高科技股份公司 阿苏事业所 |
| (2) 所在地 | 熊本县阿苏郡西原村大字鸟子312 - 8 |
| (3) 法人代表 | 三井 康诚 |
| (4) 业务种类 | 引线框架的制造 |
| (5) 开工日期 | 2017年8月 |
| (6) 扩建内容 | 蚀刻工厂、电镀工厂的新建以及相关生产设备、配套设备的导入等。 |
| (7) 投资金额 | 25亿日元 |
| (8) 投产日期 | 2018年2月(预计) |
| (9) 计划完成日期 | 2020年7月(预计) |